

## 新產品：Welco AP519 T6錫粉低溫免清洗型印刷焊錫膏

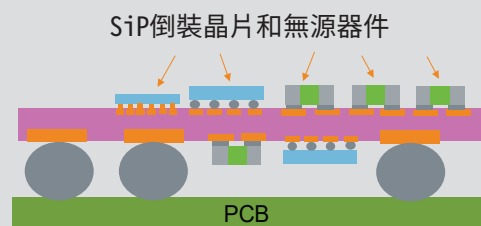
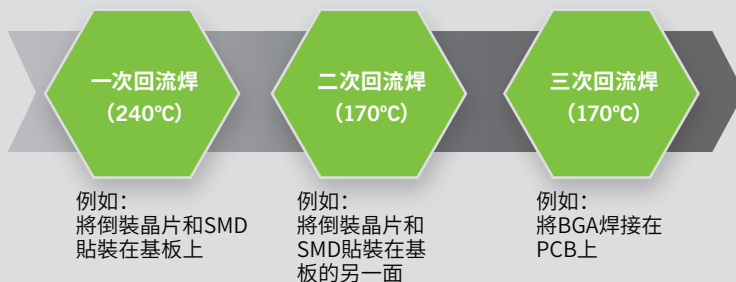
Welco AP519 T6焊錫膏採用賀利氏專有的Welco錫粉配製而成，是一款技術先進的低溫免清洗型無鉛錫膏。該產品專為回流焊峰值溫度不超過170°C的細間距半導體封裝製程而設計，包括用於系統集成封裝（SiP）和器件疊層封裝（PoP）的表面貼裝器件（SMD）或倒裝晶片貼裝製程。

### Welco AP519的優勢

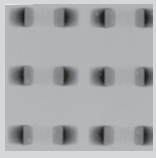
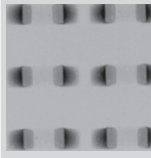
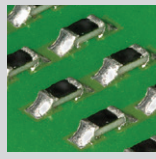
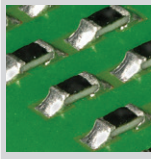
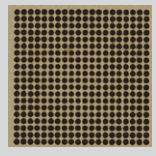
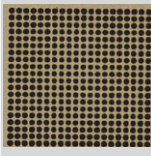
- 使用高品質Welco SnBiAg1 T6號錫粉
  - 粒度分佈集中
  - 錫粉球形度好
  - 不同批次的產品性能一致
- 回流焊峰值溫度低（170 °C）
- 極低空洞率
- 在細間距印刷中焊錫膏脫模性極佳
- 鋼板使用壽命長（≥8小時），印刷後作業時間長（≥8小時）
- 回流後，無色殘留



### 應用 / 製程



## 鋼板使用壽命測試

8小时連續印刷	0小时	8小时
<b>孔洞率 (&lt;10%)</b> 01005器件貼裝和回流焊 X-射線檢測		
<b>無橋連和立碑缺陷</b> 01005器件貼裝和回流焊 光學檢測		
<b>在細間距印刷中錫膏脫模性能穩定</b> 鋼板開孔: 100µm 線間距: 50µm 銅基板覆有機阻焊層		

## 產品特性表

物理特性	AP519
合金	Sn42/Bi57/Ag1
焊粉類型	6號Welco焊粉
鹵素含量	無鹵素
助焊劑類型	免清洗型/溶劑清洗型
粒徑	5 - 15 µm
熔點	138 - 142 °C
應用	印刷

**賀利氏電子**  
 Heraeus Deutschland GmbH & Co. KG  
 Heraeusstraße 12-14  
 63450 Hanau, Germany  
 www.heraeus-electronics.com

**美洲地區**  
 電話 +1 610 825 6050  
 electronics.americas@heraeus.com

**亞太**  
 電話 +65 6571 7649  
 electronics.apac@heraeus.com

**中國**  
 電話 +86 21 3357 5164  
 electronics.china@heraeus.com

**歐洲、中東和非洲**  
 電話+49 6181 35 3627  
 electronics.emea@heraeus.com

本文所述事实与技术数据均由贺利氏利用最新知识和现代实验设备根据通用实验流程测定得出。文中信息均为出版前最新版本（可索要最新版本文件）。尽管数据均准确无误，但贺利氏对上述数据是否得到合理引用或因引用上述数据导致的任何侵权后果均不承担任何责任（除非事先以协议的形式征得明确的书面同意）。使用者应根据本文所提供的数据针对特定应用对材料适用性进行测试。贺利氏标识、贺利氏、Heraeus和Welco®图形商标均为贺利氏集团或其附属公司的商标或注册商标。保留所有权利。